

# [邀请函]2016 年 NCAP & YOLE 先进封装和系统集成技术研讨会



2016 年 4 月 21 日-22 日上午，华进和 Yole 将在无锡携手举办为期一天半的先进封装和系统集成技术研讨会。此次研讨会报告丰富多彩，交流课题包括转接板&3D 集成、传感器&MEMS 以及硅光电学技术。会上，Yole 将同与会人员分享技术路线图及市场前景；并邀请先进封装领域的关键企业参与专题讨论环节。

本次活动演讲嘉宾来自全球知名企业，包括：ASE Group, ASM Pacific Technology, Besi, BroadPak, Evatec, EV Group, JCAP, HuaTian Technology, Plasma-Therm, SPTS/Orbotech, STATS ChipPAC, Zeta Instruments 等。

## 一、 活动时间&地址：

时 间：2016 年 4 月 21 日-22 日

地 址：无锡凯莱大饭店（无锡滨湖区高浪西路 202 号）

住宿预定：[www.wuxigloriahotel.com](http://www.wuxigloriahotel.com) 或 [res.ggwxs@wuxigloriahotel.com](mailto:res.ggwxs@wuxigloriahotel.com)（报“华进半导体”享受协议价）

## 二、 活动议程

活动议程		
4 月 21 日，星期四		
8:00-8:30	现场注册&签到	
8:30-9:00	致欢迎词	CEO, NCAP Thilbault Buisson, Technology & Market Analyst in Advanced Packaging, Yole
9:00-9:45	先进封装设备新要求	Ruurd Boomsma, CTO, Besi
9:45-11:00	Session 1: 转接板和 3D 集成技术	
9:45-10:10	先进封装 TSV&2.5D 互连技术及市场趋势	Santosh Kumar, Technology and Market Analyst, Yole Développement
10:10-10:35	扇出型和 2.5D/3D 集成的探索和协同设计方法论	Farhang Yazdani, President & CEO, BroadPak Corporation
10:35-11:00	2.5D 系统集成和 3D 晶圆级封装的 TSV 平台介绍	Wenqi Zhang, R&D Director, NCAP
11:00-11:30	茶歇	
11:30-12:45	Session 2:先进晶圆级封装技术	
11:30-11:55	华天先进晶圆级封装技术（包括扇外型技术进展）	Daquan Yu, Vice President, Huatian Technology

11:55-12:20	先进 2.5D/3D eWLB/FO-WLP 技术	Yoon Seung Wook, Director Products & Technology Marketing, STATS ChipPAC, JCET Group
12:20-12:45	TBD	
12:45-14:00	自助午餐	
14:00-15:15	Session 3: 先进封装关键制造工艺	
14:00-14:25	TBD	Thomas Uhrmann, Head of Business Development, EV Group
14:25-14:50	FOWLP-新型 PVD 技术成就快速发展的封装平台	David Butler, Vice President Marketing, SPTS Orbotech
14:50-15:15	TBD	
15:15-15:45	茶歇	
15:45-17:00	Session 4: 先进基板及系统级封装	
15:45-16:10	TBD	Steve Liang, VP, JCET
16:10-16:35	TBD	
16:35-17:00	TBD	
17:00-17:15	茶歇	
17:15-18:30	小组讨论: Is the Supply Chain ready to support the latest advancements in Packaging?	
18:30-19:30	欢迎晚宴	
4月22日, 星期五		
8:30-9:00	活动签到	
9:00-9:45	主题报告	TBD
9:45-11:00	Session 5: MEMS&传感器	
9:45-10:10	TBD	ASE Group
10:10-10:35	TBD	Steve Lerner, CEO, Alpha Szensor
10:35-11:00	MIS 平台开发	Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd
11:00-11:30	茶歇	
11:30-12:45	Session 6: 先进封装设备及材料	
11:30-11:55	先进倒装芯片互连技术	Li Ming, R&D Director, ASM Pacific technology

11:55-12:20	先进封装设备——等离子切割一体化	David Lishan, Principal Scientist, Plasma-Therm
12:20-12:45	应用于扇外型晶圆级封装的光学测量和检验	Jim, Xu, CEO, Zeta Instruments
12:45-13:10	肖特超薄玻璃及其在先进封装的应用	Feng He, Senior Application Manager, SCHOTT
13:10-13:30	活动闭幕	
13:30-14:00	自助午餐	
14:00	参观华进	

P.S. 最终议程以现场为准

### 三、 会议注册：

#### 1. 注册费用

EUR 380 (2800 CNY) 【法国企业需另付 20%VAT，中国企业需另付 6%VAT】

#### 2. 注册渠道：

##### 1) 在线注册：

<http://i-micronews.com/component/hikashop/product/ncap-yole-symposium-2016-registration.html>

##### 2) 填写注册表（详见附件一）发送至 [clotilde.fabre@yole.fr](mailto:clotilde.fabre@yole.fr)

##### 3) 如有疑问请联系：[clotilde.fabre@yole.fr](mailto:clotilde.fabre@yole.fr) 或访问会议网站：

<http://i-micronews.com/events/yole-events/eventdetail/149/-/advanced-packaging-system-integration-technology-symposium.html>

##### 4) 国内企业如需参会，也可联系：[xiaoyunzhang@ncap-cn.com](mailto:xiaoyunzhang@ncap-cn.com)，或关注我们的微信公众号“NCAP-CN”

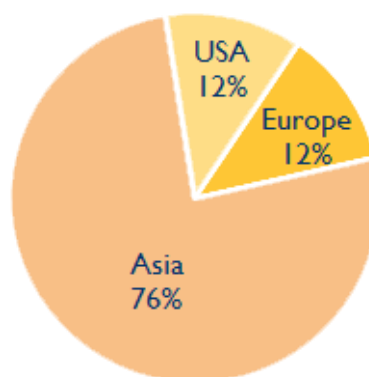
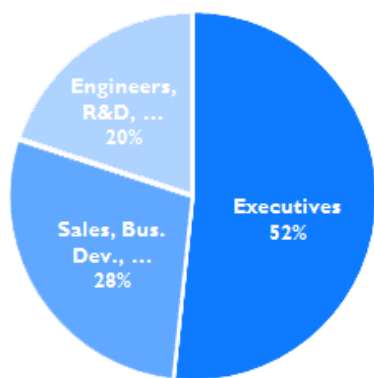


扫描二维码，了解最新资讯！

### 四、 上期回顾：

2014年8月28日在华进无锡总部举办了NCAP-Yole先进封装和系统集成技术研讨会，共吸引50余家封装行业相关企业80余人参加。华进和Yole Development的专家就先进封装与系统集成技术的新进展，2.5D/3D集成、fan-out技术、MEMS封装及其它制造技术和封装技术的发展趋势，与业界同仁进行了深入交流。众多企业嘉宾做了发言，包括韩国EPWorks CEO KIM GuSung、矽睿科技副总裁焦继伟、华天科技西安有限公司副总经理于大全、

南通富士通 HPC 封装技术 CTO 张童龙、中芯国际技术研发资深总监黄河、日月光集团研发部总监欧英德、矽品工程中心总监吕金宇，以及材料设备供货商（包括陶氏化学、SUSS、KLA、Rudolph 等）的与会代表。



### 上期参会单位清单:

Advanced Materials, Air Liquide, Air Products and Chemicals, Akrion Systems, AMEC, Amkor Technology, Analog device, ASE Group, Atotech, Beijing Future Sky Tech., BroadPak, Cirrus Logic, Consensic, Dow Chemical, Dow Corning, EPCOS Technology, EPWorks, Hitech Semiconductor, Holland High Tech China Center, Huatian Technology, Huawei Technologies, Jipal Corporation, JSR, Kingyop Optronics, KLA-Tencor, Nagase, Nanjing silverMicro Electronics, Nantong Fujitsu, Omron, QST Corporation, ROHM Semiconductor, Rudolph Technologies Chian Branch Office, SCHOTT Asia, SEMI, Shanghai Institute of Microsystem, Shinkawa, SMIC, SPIL, SPTS Technologies, SUSS MicroTec, Sumitomo Bakelite, TESEC China, Tsinghua University, Xpeedic Technology, Zeta Instruments, Zhuhai Advances Chip Carriers & Electronic Substrat Solutions technologies (ACCESS).

Organized by



Hosted by



Sponsored by

